证券代码：688035　证券简称：德邦科技　公告编号：2026-004

烟台德邦科技股份有限公司关于2025年度公司日常关联交易情况及预计2026年度公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2026年1月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度公司日常关联交易情况及预计2026年度公司日常关联交易的议案》。关联董事王建斌回避表决，此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关法律法规的规定。

2、独立董事专门会议审查意见

本议案提交公司董事会审议之前，公司于2026年1月12日召开第二届董事会独立董事第五次专门会议，对该议案进行了审议。独立董事一致认为：公司根据2026年度开展生产经营活动的需要，对与关联企业拟进行的日常关联交易进行预计，相关交易遵循了公平、合法的市场交易原则，定价公允、合理，不存在显著异常或显失公平的情形；相关交易符合公司经营所需，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不存在影响公司独立性的情形，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们对《关于2025年度公司日常关联交易情况及预计2026年度公司日常关联交易的议案》发表同意的独立意见。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

翌骅实业股份有限公司的简称为“台湾翌骅”；烟台京东方材料科技有限公司的简称为“烟台京东方”。

单位：万元，币种：人民币

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料等	台湾翌骅及同一控制	2,200.00	1.737	17.08	1186.15	1.145	2026年度预计收入增加带动采购增加及原料价格波动影响，本年采购金额较去年增幅较大。
向关联人销售产品、商品	台湾翌骅及同一控制	15.00	0.008	0	5.36	0.003	/
	烟台京东方	772.00	0.390	36.12	47.89	0.031	客户相关产品需求增加
合计	--	2,987.00	-	36.12	1239.40	-	--

注：1、2025年实际发生额未经审计，实际发生额以审计报告为准；

2、上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元，币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
向关联人购买原材料等	台湾翌骅及同一控制	1,400.00	1186.15
向关联人销售产品、商品	台湾翌骅及同一控制	10.00	5.36
	烟台京东方	0.00	47.89
合计	-	1,410.00	1,239.40

注：超出部分已履行内部决策程序，无需提交董事会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、公司名称：翌骅实业股份有限公司

公司类型：私人股份有限公司

法定代表人：骆名华

注册资本：5,000万新台币

成立日期：1996年09月05日

注册地址：桃园市龙潭区高杨南路238巷125弄24号

经营范围：芯片封装粘接剂研发、销售

实际控制人：骆名华

最近一个会计年度的主要财务数据：无（应台湾翌骅保密要求，未对外公开财务数据）

2、公司名称：烟台京东方材料科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王震宇

注册资本：80,000万人民币

成立日期：2024年10月29日

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区福莱山街道五指山路7号内1号308室

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一个会计年度的主要财务数据：公开资料未披露烟台京东方最近一个会计年度的主要财务数据。

（二）与上市公司的关联关系

1、翌骅实业有限公司作为公司控股子公司东莞德邦翌骅材料有限公司（以下简称“东莞德邦”）的少数股东，持有东莞德邦49%的股权，台湾翌骅持有翌骅实业有限公司100%的股权，公司从严将各湾翌骅及同一控制主体认定为公司关联方。

2、烟台京东方系公司持股比例18%的参股子公司，公司董事、高管王建斌同时担任烟台京东方董事。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司本次与关联方的日常关联交易预计，是为了满足公司日常业务发展需要，主要为向关联方购买货物、委托研发项目、销售货物，关联交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司与上述关联人将根据业务开展情况签署相应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，关联人具备良好的商业信誉和财务状况，有助于公司正常业务的持续开展，可降低公司的经营风险。公司业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次确认2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易情况相关事项，已经公司董事会审议通过，公司独立董事专门会议审议通过，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。公司上述日常关联交易均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的要求。保荐机构对公司确认2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易情况相关事项无异议。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码：688035　证券简称：德邦科技　公告编号：2026-005

烟台德邦科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年2月4日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年2月4日　14点30分

召开地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路66号正海大厦29层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月4日

至2026年2月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募投项目的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，相关公告已于2026年1月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接 https://vote.sseinfo.com/f/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688035	德邦科技	2026/1/29

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年1月30日17时之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱dbkj@darbond.com进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证件原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1），及委托人股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件，及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1），及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式

地址：山东省烟台市经济技术开发区珠江路66号正海大厦29层

邮编：265618

电话：0535-3467732

传真：0535-3469923

邮箱：dbkj@darbond.com

联系人：于杰

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会
2026年1月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

烟台德邦科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月4日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募投项目的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码：688035　证券简称：德邦科技　公告编号：2026-006

烟台德邦科技股份有限公司关于公司变更部分募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 原募投项目：年产35吨半导体电子封装材料建设项目（以下简称“原项目”）

● 变更后募投项目：德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目（以下简称“新项目”或“本项目”）

新项目实施主体为深圳德邦界面材料有限公司（公司全资子公司，以下简称“深圳德邦”），项目总投资金额23,049.54万元，拟使用原项目剩余募集资金共计6,236.99万元（含理财收益及存款利息，最终金额以实际结余为准，下文同）用于新项目。新项目投资总额超出募集资金投入部分，将由深圳德邦以自有或自筹资金方式补足。

● 变更募集资金投向的金额：6,236.99万元。

● 本次变更是公司综合考虑市场和行业的发展变化，根据公司经营发展需要做出的审慎决定，本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目建设周期2年，将在项目建成后陆续投产并达到设计产能。

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德邦科技”）分别于2026年1月12日和19日召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议和第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”。

公司保荐机构东方证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交股东会审议。本次变更不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527号文《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,556.00万股，每股发行价格46.12元，募集资金总额为164,002.72万元，扣除不含税发行费用152,543,951.12元后，本公司本次募集资金净额为1,487,483,248.88元。

募集资金总额扣除承销及保荐费（含税）人民币135,894,306.56元后的募集资金为人民币1,504,132,893.44元，已由主承销商东方证券股份有限公司于2022年9月14日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为535902385410508的人民币账户内，并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证验字（2022）第210029号《验资报告》予以验证。

二、募集资金投资项目情况

根据《烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《烟台德邦科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2023-014）和《烟台德邦科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-048），截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额
1	高端电子专用材料生产项目	38,733.48	38,733.48	38,439.15
2	年产35吨半导体电子封装材料建设项目	11,166.48	6,241.99	5.00
3	新建研发中心建设项目	14,479.23	17,690.85	4,000.30
4	新能源及电子信息封装材料建设项目	30,776.20	30,776.20	24,540.61
5	超募资金永久补流		55,305.80	55,353.00
合计		95,155.39	148,748.32	122,338.06

注：“超募资金永久补流”累计投入金额高于调整后投资总额系募集资金利息收入继续投入项目所致。

三、本次变更部分募投项目的原因

（一）原项目计划和实际投资情况

1、原项目名称：年产35吨半导体电子封装材料建设项目

2、原项目实施主体：四川德邦新材料有限公司

3、原项目实施地点：四川彭山经济开发区产业大道12号

4、原项目建设内容：年产35吨半导体电子封装材料建设项目实施完成后，可实现年产半导体芯片与系统封装用电子封装材料15.00吨、光伏叠晶材料20.00吨的产能。

5、原项目达到预定可使用状态日期：2026年9月

6、原项目实际投资进度：截至2025年6月30日，年产35吨半导体电子封装材料建设项目累计已实际投入募集资金5.00万元，该项目尚未使用的募集资金为6,236.99万元，存放于募集资金专户中。

（二）本次变更部分募投项目的原因

本次对部分募投项目进行变更的主要原因如下：

1、公司原项目“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”，是结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况制定，并经过充分研究与论证。近年来，市场与行业环境发生深刻变化，原项目的产能扩张计划已不再具备先前的紧迫性。基于对当前市场环境和行业发展趋势的深入分析，结合公司整体战略规划，为更好地支持长远发展，公司决定终止该原项目。

2、通过新项目“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”的实施，公司有望实现多方面关键效果：一是摆脱租赁场地依赖，提升生产稳定性、以及生产效率与质量，为生产优化和研发提供稳定硬件载体；二是支撑产能扩张，助力公司达成营收增长目标；三是承接集团南方基地战略，依托深圳政策与产业优势，对接核心客户、优化供应链并吸引高端人才；四是巩固导热界面材料领域竞争优势，保障订单响应、推动产品升级，巩固国产替代地位并助力细分市场拓展。

综上，本次将原募集资金投资项目“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”，是公司基于当前市场环境、行业趋势及自身战略规划作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，更好地把握市场发展机遇，应对行业变化挑战，对增强公司盈利能力、巩固核心竞争优势具有重要意义，具备充分的合理性与必要性。

四、新项目的具体情况

（一）基本情况

1、新项目名称：德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目

2、新项目实施主体：深圳德邦界面材料有限公司

3、新项目实施地点：广东省深圳市龙岗区洪图地块

4、新项目建设内容：本项目将与村集体合作开发一块工业用地，该地块已依据深圳专属政策完成农村用地向国有用地的性质转换，并在该地块新建厂房与宿舍，以解决深圳德邦现有租赁场地生产拥挤、实验室面积不足、布局不合理的问题；同时，项目将引入更先进的自动化生产设备，优化导热界面材料的生产工艺，提升导热界面材料和导电胶等核心产品的产能，并配套建设更完善的材料可靠性分析测试实验室，强化核心技术的迭代研发。

新项目产品主要为导热材料及EMI材料，细分为导热膏、导热泥、导热凝胶、导热垫片、相变材料、导电胶等，达产后预计年产能为450吨。

5、新项目实施周期：2年

6、新项目资金：项目总投资金额23,049.54万元，拟使用原项目剩余募集资金6,236.99万元用于本项目。以上项目投资总额超出募集资金投入部分，将由深圳德邦以自有或自筹资金方式补足。

投资结构如下表所示：

序号	项目名称	项目投资总额	投资比例
1	建设投资	19,057.01	82.68%
1.1	工程费用	18,556.00	80.50%
1.1.1	建筑工程费	16,356.00	70.96%
1.1.2	设备购置费	2,200.00	9.54%
1.2	预备费	501.01	2.17%
1.2.1	基本预备费	501.01	2.17%
2	建设期利息	637.90	2.77%
3	铺底流动资金	3,354.63	14.55%
4	项目总投资	23,049.54	100.00%

7、新项目备案、环评情况

公司尚未取得用以实施本项目的土地的使用权，公司将在取得实施本项目的土地的使用权后及时办理项目备案和环评手续，后续公司将按照项目进展情况及时履行信息披露义务。

（二）必要性分析

1、自建厂房为业务规模持续扩张筑牢基础

自建标准化厂房是深圳德邦锚定中长期营收增长目标、实现业务规模持续扩张的关键战略举措，将从生产效能提升、研发能力突破、战略发展保障三大维度，为公司高质量发展筑牢坚实基础。

在生产运营层面，自建厂房可依据生产流程与工艺需求，科学规划生产区、仓储区、辅助区等功能板块，实现设备排布的最优布局与生产环节的无缝衔接，大幅提升生产流转效率；同时，充足且规整的操作空间能够从根本上消除安全隐患，构建安全高效的现代化生产体系，为产能稳步爬坡提供可靠保障。

在技术研发层面，自建厂房将配套建设规模化、专业化的研发检测中心，不仅可充分容纳DSC、TGA、激光粒度分析仪等先进检测设备，更能为研发团队开展高导热材料迭代、填料表面改性等核心技术攻关提供充足的实验空间，助力技术研发周期缩短与成果转化效率提升，强化公司技术创新的核心竞争力。

在战略发展层面，自有土地与厂房的产权属性，彻底打破租赁模式下的场地拓展限制与布局约束，既可以根据业务增长需求灵活扩容场地面积，也能够按照生产研发的个性化需求动态调整空间规划，为公司营收目标的稳步达成与业务版图的持续扩张，提供长期稳定、自主可控的场地支撑，确保公司发展节奏始终保持稳健向上的良好态势。

2、承接集团战略布局，最大化释放深圳政策与区位价值

深圳德邦作为德邦科技全资子公司，发展需紧密契合德邦科技整体战略规划。公司正打造南方基地，深圳在高新技术产业领域拥有丰富的政策支持资源，包括固定资产投资补贴、技术攻关资助、高端人才奖励等，同时其备完善的半导体、电子信息产业生态。深圳区域的人才、政策及产业链不仅将极大助力公司的导热界面材料业务发展，还能为公司带来参与重大项目的可能性，为公司集团战略落地提供关键支撑。

本项目所建设南方基地将承载我司在南方区域的运营，长期享受政策红利、降低投资与运营成本，充分融入深圳的产业生态，依托区位对接核心客户、优化供应链、吸引高端人才，为公司深耕南方市场奠定基础，推动集团整体战略布局的高效落地。

3、保障产能匹配市场需求，巩固并强化核心竞争优势

从市场与自身实力来看，深圳德邦已具备坚实的竞争基础，作为国家科技重大专项的产业化平台，其在导热界面材料领域拥有多项已授权发明专利，同时还有大批专利处于申请流程中，核心产品量产，服务各领域龙头企业，部分产品还实现了国产替代甚至独家供应，市场认可度与客户黏性极高。当前相关领域市场需求持续攀升，带来广阔的市场机遇及增长空间。充足灵活的产能支撑，是高效承接市场订单、深化与头部客户战略合作、持续巩固并提升公司行业竞争优势的关键前提。

自建厂房可优化生产布局、引入先进设备，提升效率与产品质量，保障产能匹配需求，巩固公司核心竞争优势。此外，配套完善后的测试实验室将助力技术研发，推动核心技术迭代，开发高性能产品，巩固国产替代地位，增强客户信心、拓展市场份额，强化公司核心竞争优势。

（三）可行性分析

1、国家政策支持导热界面材料行业发展

导热界面材料是我国电子信息产业高质量发展的关键支撑，其技术突破与产能提升直接关系到下游消费电子、新能源汽车、通信设备及数据中心等核心领域的散热效率、产品可靠性及产业竞争力。近年来，我国出台了一系列产业政策，支持和鼓励导热界面材料行业发展。国家产业政策的支持将为热界面材料市场带来持续上行的市场前景，为本项目的实施营造了良好的政策环境。

2、本项目技术具备充分可行性且支撑项目落地运营

本项目聚焦导热界面材料生产，项目技术可行性的核心在于，核心生产技术成熟且具备落地条件，关键支撑技术已实现成熟应用，形成了完整的技术体系，可稳定支撑产品量产。

从技术研发与保障能力看，深圳德邦实力强劲，能为项目提供支撑：作为国家科技重大专项产业化平台，其研发体系与硬件基础完善，在导热界面材料领域拥有多项已授权发明专利，搭建了多个专业研究室及实验室，配备先进测试仪器与可靠性分析设备，可满足技术迭代与质量检测需求；研发团队由陈田安博士领军，专职研发力量配置充足，且以股权激励绑定核心人才，能持续推动材料优化与工艺改进，为项目技术升级提供人力与研发保障。

在生产工艺与质量控制上，项目技术可行性有充分验证：生产端形成成熟工艺体系，通过表面改性、分步加料搅拌保障高填料下材料柔韧性与流动性，用精密压延或模具成型控导热垫片厚度公差，借真空搅拌脱泡保产品致密可靠；质量端获ISO9001等多项认证，设专职团队，全流程管控质量，符合宁德时代等核心客户要求，印证技术在生产与市场应用中的可行性。

3、本项目用地具备明确可行性且获取过程合法合规

土地性质转换合规无法律风险，项目用地原为村集体用地，后续将严格遵循深圳市特有的政策流程，完成农村用地向国有用地的转换。该转换路径是深圳土地管理体系内的成熟合规模式，完全契合当地土地管理专项要求，不存在性质转换层面的法律隐患。

土地用途与项目需求高度适配，该用地已明确划定为工业用地，与项目核心需求----建设厂房开展导热界面材料的生产、研发及配套工作完全匹配。不仅能支撑深圳德邦科学划分生产区、研发区、检测区等功能区域，更可直接为产能扩张、技术研发提供适配场地，有力保障深圳德邦中长期营收目标与规模目标落地。

合作开发获取方式合规可行，项目采用村集体合作开发模式获取土地，该模式在深圳国有化转换后工业用地开发中具备实操基础。合作将严格遵循深圳集体用地合作开发流程，明确各方权责，确保开发全流程合规，无合作模式层面的合规隐患。

（四）经济效益分析

本项目整体建设期为两年，在实现前述预期产出的前提下，项目税后内部收益率处于良好区间，各项关键财务指标稳健，项目实施具备经济可行性。但若相关行业及市场等外部环境发生变化，则测算的内部收益率情况将随之发生变化。

五、风险提示

（一）市场风险

由于未来国际环境变化、宏观政策变化、市场供求状况、行业竞争情况、技术进步等因素存在一定的不确定性，“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”可能存在实施进度延缓或投资效益不达预期的风险。

（二）新建产能爬坡期的风险

随着新建产能的投入，厂房建造和装修费用开始摊销，生产相关设备也开始折旧，而产线通过体系认证需要时间，公司产品导入测试生产也需要时间，产能投入使用将呈现陡续爬坡的态势。若产能利用率爬坡速度较慢，则项目效益实现滞后，前述各项折旧摊销可能会影响公司净利润。

（三）项目实施风险

本项目尚需向政府有关部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等各项前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

六、本次变更部分募集资金投资项目后的募集资金管理

为保障新募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向深圳德邦提供无息借款。

鉴于本次募投项目变更调整事项，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次募投项目变更调整相关事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续及签署其他相关文件并办理有关手续、办理增加募集资金专户相关事宜。若后续公司拟相应增加募集资金专户，公司将与保荐机构、募集资金专户银行签署募集资金专户监管协议，规范公司募集资金存放与使用。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求使用募集资金，确保募集资金的使用合法、有效。

七、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响

公司本次变更部分募投项目是公司综合考虑市场、行业环境的发展变化，根据公司经营发展战略需要做出的审慎决定，本次调整将进一步提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

八、公司履行的审议程序

公司分别于2026年1月12日和19日召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议和第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。本议案尚需公司股东会审议。

九、专项意见说明

1、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次将“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”变更为“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”，是公司经过审慎分析后做出的决定，综合考虑了公司业务需求及项目实际实施情况，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

2、保荐机构意见：

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司本次变更部分募投项目，系基于公司实际经营发展需要，并充分考虑了公司长期发展的战略规划而实施，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码：688035　证券简称：德邦科技　公告编号：2026-003

烟台德邦科技股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保方：深圳德邦界面材料有限公司（以下简称“深圳德邦”），系烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额：公司本次拟担保总额不超过15,000万元，截至本公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额22,500万元、公司对控股子公司提供的担保总额22,500万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例9.81%、7.58%。

● 本次担保无反担保。

● 本次为全资子公司申请综合授信提供担保的事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、本次申请综合授信额度并提供担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为满足项目建设的资金需求，确保项目顺利推进，深圳德邦拟向银行申请综合授信额度，授信金额不超过15,000万元，授信期限不超过10年。深圳德邦将以固定资产（包括所购置的土地及建成的厂房）进行抵押，公司拟为深圳德邦本次借款提供全额担保，具体担保条款以最终签署的正式担保合同为准。

（二）履行的内部决策程序

公司于2026年1月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

在提交董事会会议审议之前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）深圳德邦界面材料有限公司

1、成立日期：2010年11月16日

2、注册地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区教育北路88号4号厂房102、202、301

3、法定代表人：CHEN TIAN AN

4、经营范围：一般经营项目是：国内贸易；货物进出口、技术进出口。许可经营项目是：界面材料、导电材料、电子材料、绝缘材料、导热材料的研发、生产与销售。

5、深圳德邦为公司持股100%的全资子公司。

6、主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	11,902.56
负债总额	4,492.56
净资产	7,410.00
项目	2024年12月31日（经审计）
营业收入	11,291.89
净利润	1,325.13
扣除非经常性损益后的净利润	1,150.92

以上财务数据均经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

7、为确保借款合同的顺利签署，深圳德邦除以固定资产抵押外，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。深圳德邦信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司和深圳德邦尚未签订相关担保及授信协议，上述综合授信计划额度及担保总额，分别仅为深圳德邦拟申请的综合授信规模和公司拟为其提供的担保额度。具体贷款金额、担保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容尚需银行审核确认，最终以各方实际签署的正式合同为准。

四、担保的原因及必要性

深圳德邦作为公司全资子公司，为满足募投项目“德邦半导体材料研发与生产（华南）基地建设项目”的资金需求，拟向银行申请贷款。公司为深圳德邦的综合授信提供担保，有利于提升子公司的融资能力，保证项目所需资金及时到位，确保项目顺利实施，符合公司整体发展战略。作为深圳德邦的控股股东，公司能够及时掌握其日常经营状况，对其担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、相关意见

（一）董事会意见

公司董事会认为：本次公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，因此，我们一致同意该议案。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次向银行申请综合授信额度并提供担保事项符合公司业务开展的实际需求，有利于公司及其下属子公司的业务拓展，符合上市公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次申请预计担保事项符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

4、本次股东权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体内容详见公司同日披露的《简式权益变动报告书》